

目录

| | |
|---|---|
| 留意期刊: | 2 |
| THE VISUAL COMPUTER(TVC) | 2 |
| IEEE SENSORS JOURNAL(IEEE trans) | 2 |
| IEEE Access(名声很臭，但是好投) | 3 |
| IEEE Transactions on Industrial Informatics(双一区, top) | 3 |
| IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | 4 |
| ICME ICASSP | 4 |
| 期刊会议相关 | 6 |
| 期刊层次查询网站 | 6 |
| 文献来源 | 6 |
| 综述_Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey | 6 |
| 综述_Deep 3D Object Detection Networks Using LiDAR Data A Review | 7 |
| 综述_A Survey on 3D Object Detection Methods for Autonomous Driving Applications | 7 |
| 综述_作为一个 0 基础三维点云深度学习的研究生，如何快速入 门？ - 知乎 (zhihu.com) | 7 |

留意期刊：

THE VISUAL COMPUTER(TVC)

大类 3 区 | 小类 3 区 | CCF-C | 2022 年影响因子：3.5

<https://www.x-mol.com/8Paper/1201710392250535936>

审稿周期还可以，5 个月左右

| VISUAL COMPUTER | | | |
|-----------------|--|----|-------|
| 刊名 | VISUAL COMPUTER | | |
| 年份 | 2021 | | |
| ISSN | 0178-2789 | | |
| Review | 否 | | |
| Open Access | 否 | | |
| Web of Science | SCIE | | |
| | 学科 | 分区 | Top期刊 |
| 大类 | 计算机科学 | 3 | 否 |
| 小类 | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 计算机: 软件工程 | 3 | - |

IEEE SENSORS JOURNAL(IEEE trans)

IEEE SENSORS JOURNAL | 审稿快，但第一次大修重投是基本操作 | 名声不错，但是跟计算机方向不太吻合

| 2021年 | | | |
|----------------------|--|----|-------|
| IEEE SENSORS JOURNAL | | | |
| 刊名 | IEEE SENSORS JOURNAL | | |
| 年份 | 2021 | | |
| ISSN | 1530-437X | | |
| Review | 否 | | |
| Open Access | 否 | | |
| Web of Science | SCIE | | |
| | 学科 | 分区 | Top期刊 |
| 大类 | 工程技术 | 2 | 否 |
| 小类 | INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 仪器仪表 | 2 | - |
| | PHYSICS, APPLIED 物理: 应用 | 2 | |
| | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程: 电子与电气 | 3 | |

IEEE Access(名声很臭，但是好投)

| | | | |
|----------------|--|----|-------|
| 2021年 | | | |
| IEEE Access | | | |
| 刊名 | IEEE Access | | |
| 年份 | 2021 | | |
| ISSN | 2169-3536 | | |
| Review | 否 | | |
| Open Access | 是 | | |
| Web of Science | SCIE | | |
| | 学科 | 分区 | Top期刊 |
| 大类 | 计算机科学 | 3 | 否 |
| 小类 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程：电子与电气 | 3 | - |
| | TELECOMMUNICATIONS 电信学 | 3 | |
| | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 计算机：信息系统 | 4 | |

IEEE Transactions on Industrial Informatics(双一区, top)

分区很高，并且风评不错，所以难是肯定的。

但是，学科比较杂，定位不清楚，相较于计算机领域的 top 期刊，这个可能好一些。

| | | | |
|---|--|----|-------|
| IEEE Transactions on Industrial Informatics | | | |
| 刊名 | IEEE Transactions on Industrial Informatics | | |
| 年份 | 2021 | | |
| ISSN | 1551-3203 | | |
| Review | 否 | | |
| Open Access | 否 | | |
| Web of Science | SCIE | | |
| | 学科 | 分区 | Top期刊 |
| 大类 | 计算机科学 | 1 | 是 |
| 小类 | AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 自动化与控制系统 | 1 | - |
| | COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 计算机：跨学科应用 | 1 | |
| | ENGINEERING, INDUSTRIAL 工程：工业 | 1 | |

IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS

审稿周期短，其他没了解

| | | | |
|--------------------------------|---|----|-------|
| 2022年 ▾ | | | |
| IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | | | |
| 刊名 | IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS | | |
| 年份 | 2022 | | |
| ISSN | 1070-9908 | | |
| Review | 否 | | |
| Open Access | 否 | | |
| Web of Science | SCIE | | |
| | 学科 | 分区 | Top期刊 |
| 大类 | 工程技术 | 2 | 否 |
| 小类 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 工程：电子与电气 | 3 | - |

ICME | ICASSP

CCF-B

毕业神会，其他没了解

IET Computer Vision(四区，审稿快)

***ICRA && RAL[期刊] (CCF-B)

还有个机器人领域顶会，IROS，CCF-C

[\(54 封私信 / 80 条消息\) 机器人领域最好的会议是什么? - 知乎 \(zhihu.com\)](#)

机器人领域顶会，但如果投 cv 相关难度会小一些

每年 9 月份截稿 – 来年 1 月份出录取通知

常年录取率在 40%左右

ICRA

我目前投ICRA的战绩是六投六中，感觉ICRA的审稿人都比较reasonable，但同时又很实际。你可以只用仿真，设计的算法可以是已有的东西拼接起来的，但是你解决的问题一定要具有独特的意义，并且你的算法是为你问题服务的。审过不少把ICRA完全当视觉会议投的，模型搭了一堆积木，却说不出为什么这样搭，最后又没讲清楚能解决啥实际问题，这种大概率挂。所以ICRA里你设置问题的setting非常重要。

IEEE Robotics and Automation Letters(RAL)

ieee robotics and automation letters

实力：16年创刊，两年的h5 index 已经20多了，等到5年统计完全后必然到达icra差不多水平（icra 目前是谷歌学术^Qro领域第一h5 为75）。今年中肯定会收入sci，目测至少jcr 2区以上？

另外，它可以跟ICRA IROS RSS等会议合作投同一篇，一次审稿，有两个committee独立决定录取。

再另，他承诺180天时效：180天内，要不发表，要不拒稿。

利益相关：本人投了icra 19 with ral option，两方均已中。RAL审稿质量明显高于icra iros^Q，而且非常快，比承诺还快。打算以后每年都投...

可以和 ICRA 同投，而且速度快!!!

今年开始已经没有ral optional with iros/icra的选项了吗？

发现好像官网已经没有联投了，只有中了ral才可以推会议

Shit

期刊会议相关

期刊层次查询网站

| |
|---|
| https://www.x-mol.com/8Paper/list |
| 中国科学院文献情报中心期刊分区表 (fenqubiao.com) |
| |

文献来源

| |
|--|
| ICCV – ECCV – CVPR 图形学顶会 SIGGRAPH |
| 精选了 61 篇三维点云顶会论文及源码分享, 含 2023 最新 - 知乎 (zhihu.com) |
| Docs (feishu.cn) |
| (45 封私信 / 80 条消息) 有没有人可以一个人在家发表图形学顶会 (SIGGRAPH) 论文? - 知乎 (zhihu.com) |
| Peng-Shuai Wang (wang-ps.github.io) |
| 王鹏帅-AI2000-北大王选计算机实验室-三维深度学习 |

综述_Deep Learning for 3D Point Clouds: A Survey

| |
|---|
| 【论文阅读·综述】Deep Learning for 3D Point Clouds: A |
|---|

| |
|--|
| Survey_deep learning for 3d point clouds: a survey 论文阅读-CSDN |
| 博客 |
| |

综述_Deep 3D Object Detection Networks Using LiDAR Data A Review

综 述 _A Survey on 3D Object Detection Methods for Autonomous Driving Applications

综述_[作为一个 0 基础三维点云深度学习的研究生，如何快速入门？ - 知乎 \(zhihu.com\)](#)